

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于苏州锴威特半导体股份有限公司**  
**2024 年度持续督导跟踪报告**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：苏州锴威特半导体股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：牟晶          | 联系电话：021-38966911      |
| 保荐代表人姓名：吕瑜刚         | 联系电话：021-38966911      |

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，对锴威特进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

## 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

### （一）业绩大幅下滑或持续亏损的风险

2024年度，公司实现营业总收入13,013.44万元，较上年同期下降39.12%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,789.40万元，较上年同期下降650.12%。受全球经济增速下行以及竞争格局加剧等多重因素的影响，公司产品销售价格和毛利率有所下降。公司为保持技术和产品的竞争力，在未来一段时间内仍将投入较多研发费用，实现对各种型号产品、各种细分品类功率器件芯片的覆盖，同时增

加市场推广、渠道建设、客户服务体系建设、管理水平提升等方面的投入以增强公司的整体实力。公司短期营收规模还无法覆盖中长期战略布局投入需求是公司在2024年度出现亏损的主要因素之一。未来受市场需求变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，或公司产品竞争力无法持续提升，或公司经营规模效应无法充分体现，公司的销售收入将可能面临较大幅度波动的情况，公司无法实现盈利的时间将延长，从而影响公司经营现金流、财务状况、团队稳定和人才引进，进而对公司业绩产生不利影响。

## （二）核心竞争力风险

### 1、新产品研发及产业化不及预期的风险

半导体行业的研发存在周期较长、工艺复杂等特点，产品技术优化升级需要持续的资源投入。由于新品研发至实现规模销售需要一定的时间周期，公司功率器件、功率IC新产品的研发进度及研发成果实现产业化都存在不确定性。如果新产品研发及产业化进度未达预期或无法在市场竞争中占据优势，公司将面临新产品研发及产业化失败的风险，前期的研发投入也将无法收回，给公司未来业务拓展带来不利影响。

### 2、技术泄密的风险

集成电路设计行业为技术密集型行业，核心技术是行业内企业保持领先优势的重要保障，对企业发展具有重要作用。基于多年的技术积累和研发投入，公司在功率半导体领域已形成多项核心技术，并广泛应用于自有产品中，同时公司正致力于新技术和新产品的研发。如果公司核心技术人员流失或个别人员核心资料保管不善，则可能导致公司核心技术失密的风险。若公司核心技术泄密，并被竞争对手所获知和模仿，则可能会削弱公司的竞争优势，并对公司生产经营带来不利影响。

## （三）经营风险

### 1、晶圆委外加工及产能供应稳定性的风险

目前，公司采用Fabless经营模式，专注于芯片的设计、研发和销售环节，而将晶圆制造、封装测试等生产环节委托供应商进行。若晶圆代工、封装测试等委

外加工价格大幅上涨，或因晶圆代工厂、封装测试厂产能紧缺或工艺波动等原因影响公司产品供给，将对公司供应稳定性、盈利能力造成不利影响。若未来公司与主要晶圆供应商的合作关系发生不利变化，或主要供应商由于产能受限等原因而降低对公司的产能供给，而公司在短期内无法及时寻找新的晶圆供应商并快速获取产能形成稳定供应，将影响公司晶圆供应的稳定性，从而对公司生产经营造成不利影响。

## 2、供应商集中度较高的风险

目前，公司采用Fabless经营模式，专注于芯片的设计、研发和销售环节，而将晶圆制造、封装测试等生产环节委托供应商进行。由于资金、技术等壁垒，半导体行业内符合公司技术和工艺要求的晶圆代工厂数量较少。若未来公司主要供应商出现产能受限、自身生产经营或与公司合作情况发生不利变化等情况，公司在短时间内替换供应商存在较大困难，可能导致公司不能足量、及时出货，从而对公司生产经营造成不利影响。

## 3、关键技术人员流失的风险

目前国内半导体企业众多，对功率半导体关键技术人员需求缺口较大，运用高薪或者股权激励等方式吸引技术人员已逐渐成为行业内的常规手段，导致行业内人员流动愈发频繁。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人才发展及内部晋升受限，公司对关键技术人才的吸引力将减弱，甚至可能出现现有关键技术人员流失的情形，对公司生产经营产生不利影响。

## （四）财务风险

### 1、收入规模下降的风险

持续督导期内，国产器件厂商面临市场需求萎靡、行业竞争加剧等不利局面，产品价格下滑。同时叠加成本增加等因素推动，公司产品销量和价格下降明显。若未来半导体行业市场供需关系未得到有效调整或者市场竞争持续加剧导致公司不能保持产品的核心竞争力和市场竞争优势，则会对公司产品售价、销量造成进一步负面影响，并可能导致客户订单执行延缓或出现违约、主要客户流失，从而使公司面临收入增长下降的风险。

此外，公司功率IC产品主要面向高可靠领域，该领域客户订单在一定程度上会受到年度预算和终端需求等因素的影响。若未来客户订单延迟或取消、公司未能准确把握行业技术发展趋势或下游市场需求发生重大不利变化等，可能导致公司功率IC业务出现新客户拓展不达预期、现有客户流失等情形，从而使公司面临收入增长下降的风险。

## 2、毛利率及盈利能力下降的风险

受宏观经济环境、地缘政治变局、行业周期等不利因素的扰动，2024年度公司主要产品毛利率出现一定程度下滑。随着市场需求的变化和行业技术的发展，若公司未能正确判断市场需求变化、技术水平停滞不前、未能有效控制产品成本或市场竞争格局发生不利变化，将会导致公司产品售价和成本出现预期外的波动，公司产品毛利率及盈利能力未来存在下降的风险。

## 3、存货滞销及减值的风险

2024年度下游市场需求持续疲软，相关产业链整体呈现去库存压力。若未来下游领域需求端持续低迷或市场环境发生其他不利变化、客户临时改变需求、竞争加剧或技术升级，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，导致产品滞销、周转天数延长、存货积压，公司可能面临存货滞销及减值的风险。

## 4、应收账款增加及减值的风险

受行业不利因素及部分客户管理体系与预算支出调整的影响，2024年度部分市场产品出现客户需求下降、新增订单不及预期、客户成本诉求增加等不利情况。若未来下游需求端持续低迷或市场环境发生其他不利变化，公司不能有效加强应收账款的催收，导致应收账款增加，则公司可能面临发生坏账的风险，进而会对公司的盈利能力产生不利影响。

## 5、公司期间费用增加的风险

根据本公司战略发展规划，未来在新产品开发、新市场拓展以及业务布局上需要充足资金支撑公司业务发展，同时，公司为了留住人才，在保持公司人员稳定的前提下吸纳了部分具有资深从业经历的人士，并对现有员工整体薪酬水平作出了一定合理调整。在此背景下，研发、销售、管理成本均有所提高，财务费用

也将增加，导致期间费用大幅增加而未能通过营业收入的增长予以消化，将可能对公司短期内的经营业绩产生不利影响。

## （五）行业风险

### 1、技术迭代风险

公司主要经营的产品包括功率器件和功率IC，两者均属于功率半导体。功率半导体行业属于技术密集型行业，不追求先进制程，产品生命周期长，较数字芯片相比迭代速度慢。从技术发展层面来看，一方面，下游客户的个性化需求不断丰富，下游应用领域对产品技术参数要求亦不断提升，如公司无法顺应行业技术发展趋势，在产品研发中紧跟下游客户应用需求的变动方向，则有可能导致公司产品被赶超或替代。

### 2、市场竞争风险

目前，我国的功率半导体行业正经历快速发展阶段，行业内厂商积极进行市场拓展，市场竞争逐渐加剧。公司所处行业的竞争对手较多，既包括英飞凌、安森美等国际一流功率半导体厂商，也包括华润微、士兰微等国内的知名功率半导体厂商。公司需要持续投入大量资金用于核心技术及新产品的研发，以缩小与竞争对手的差距并保持自身竞争力。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时推出新产品、不断优化产品性能与提高服务质量，则可能导致公司竞争能力下降，公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

## （六）宏观环境风险

### 1、国际贸易摩擦的风险

在经济全球化日益深化的背景之下，国际贸易关系的变化对于半导体行业景气度可能产生深远影响。部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展；尤其是随着中美贸易摩擦的加剧，美国政府已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”。若美国将公司及公司主要客户、供应商列入“实体清单”名单或采取其他经济限制手段，可能导致公司业务受限、供应商无法供货或者客户采购受到约束，公司的正常生产经营将受到不利影响。同时，半导体

产业链上下游可能出现生产和采购受限的情形，从而对公司经营业绩造成不利影响。

## 2、产业政策变化风险

半导体产业是国家战略性产业。近年来，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体产业的发展，增强了中国半导体产业的创新能力和国际竞争力，带动了整个产业的发展。但若未来国家相关产业政策支持力度减弱，可能导致下游市场需求下滑、税收优惠减少、政府补贴金额下降等，公司的经营业绩可能会因此受到不利影响。

## 三、重大违规事项

无。

## 四、主要财务指标的变动原因及合理性

主要会计数据及主要财务指标如下：

单位：万元

| 主要会计数据                 | 2024 年度    | 2023 年度    | 2024 年度较 2023 年度<br>同期增减（%） |
|------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 营业收入                   | 13,013.44  | 21,374.33  | -39.12                      |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -9,789.40  | 1,779.50   | -650.12                     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,896.31 | 813.79     | -1,438.96                   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -5,167.49  | -3,614.92  | 不适用                         |
| 主要会计数据                 | 2024 年末    | 2023 年末    | 2024 年末较 2023 年末<br>同期增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 90,452.94  | 102,231.81 | -11.52                      |
| 总资产                    | 96,476.80  | 106,631.48 | -9.52                       |
| 主要财务指标                 | 2024 年度    | 2023 年度    | 2024 年度较 2023 年度<br>同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股）            | -1.33      | 0.29       | -558.62                     |
| 稀释每股收益（元/股）            | -1.33      | 0.29       | -558.62                     |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）  | -1.48      | 0.13       | -1,238.46                   |

|                         |        |       |               |
|-------------------------|--------|-------|---------------|
| 加权平均净资产收益率（%）           | -10.15 | 3.12  | 减少 13.27 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -11.3  | 1.43  | 减少 12.73 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%）         | 45.18  | 16.85 | 增加 28.33 个百分点 |

2024年，公司实现营业总收入13,013.44万元，较上年同期下降39.12%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,789.40万元，较上年同期下降650.12%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10,896.31万元，较上年同期下降1,438.96%。2024年公司的营业收入、利润水平及每股收益较2023年同期均有不同程度的下滑，主要系：一方面，2024年度宏观经济增长放缓，公司所处功率半导体行业下游终端市场整体维持温和复苏格局。在消费类市场，由于市场竞争激烈，公司产品价格承压；在高可靠领域，由于下游需求不足，成本诉求增加，导致销售规模有所下降。另一方面，公司坚持创新驱动，不断巩固和提升公司产品技术领先和创新优势，在研发人员引进、产品研发等方面持续加大研发投入，同时为持续开拓市场和销售渠道，加大营销队伍建设、市场推广和品牌建设等市场营销资源投入，积极应对市场变化，导致经营性费用增加。整体来看，公司期间费用的增加对净利润造成了阶段性影响。

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系：营业收入下滑导致销售回款减少及经营性支出增加所致。

关于公司亏损事项，保荐机构已在报告之“二、重大风险事项”之“（一）业绩大幅下滑或持续亏损的风险”对相关风险进行提示。保荐机构就业绩亏损事项已与公司进行沟通，提示公司积极措施应对市场变化，提升管理效率，强化内控规范，防范潜在风险，做好相关信息披露工作，切实保护投资者利益。保荐人提请投资者特别关注公司业绩大幅下滑或持续亏损的风险。

## 五、核心竞争力的变化情况

本持续督导期内，公司所处功率半导体行业下游终端市场整体维持温和复苏格局。在消费类市场，由于市场竞争激烈，公司产品价格承压；在高可靠领域，由于下游需求不足，成本诉求增加，导致销售规模有所下降。另一方面，公司坚持创新驱动，不断巩固和提升公司产品技术领先和创新优势，在研发人员引进、

产品研发等方面持续加大研发投入，同时为持续开拓市场和销售渠道，加大营销队伍建设、市场推广和品牌建设等市场营销资源投入，积极应对市场变化。

## 六、研发支出变化及研发进展

2024年度，公司研发支出为5,879.22万元，同比增长63.22%；研发投入占收入比例为45.18%，同比增加28.33个百分点。公司推动产品的技术高效升级，不断提升产品质量和性能，同时在产品谱系的完善、技术迭代升级、前道及封装工艺优化、质量检测及模具等方面加大研发投入。

PWM控制IC方面：公司持续丰富产品线，完成了反激、正激、半桥、推挽、全桥、移相全桥等隔离拓扑产品系列化，推出了输入电压高达100V以上同步Buck控制器、同步Boost控制器等新品。为提高电源系统效率，推出了可支持反激、QR、LLC等拓扑的同步整流驱动IC，工作频率可高达1MHz，工作电压可达300V。

功率驱动IC方面：公司推出80V 3A集成MOSFET的单芯片H桥驱动芯片，同时可支持100%占空比工作中，进一步提升系统的安全及可靠性；公司推出180V GaN专用半桥驱动芯片，工作频率高达1MHz以上。

在功率MOSFET方面，2024年公司开发完善了沟槽MOSFET及高压超结的工艺平台优化和产品布局，开发了40V、60V、80V、100V SGT工艺平台并完成了12寸晶圆产线的工艺开发。

SiC MOSFET方面：公司加大SiC MOSFET加工的产能布局及工艺平台的开发，2024年与国内晶圆代工厂合作开发了1200V、1700V、2600V、3300V SiC MOSFET的生产工艺平台，其中1200V SiC MOSFET工艺平台已成功进入中试阶段，新推出2600V和3300V SiC MOSFET产品，目前产品进入小批验证阶段。截至2024年末，公司已获授权专利113项（其中发明专利70项、实用新型专利43项），集成电路布图设计专有权99项。

## 七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

## 八、募集资金的使用情况及是否合规

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户主体           | 开户行                    | 银行账号                 | 初时存放金额         | 截止日余额          | 账户类别 | 资金用途            |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|------|-----------------|
| 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司张家港支行        | 75120122000667875    | 144,732,700.00 | 6,462,150.38   | 活期   | 智能功率半导体研发升级项目   |
| 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司张家港分行      | 32250198623600003914 | 87,278,500.00  | 7,181,967.05   | 活期   | SiC 功率器件研发升级项目  |
| 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行 | 1102028129000182958  | 168,071,600.00 | 2,856,024.76   | 活期   | 功率半导体研发工程中心升级项目 |
| 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司      | 8018288813307        | 158,666,407.76 | 已注销            | 活期   | 补充营运资金          |
| 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 招商银行股份有限公司张家港支行        | 512905680810818      | 134,716,121.90 | 97,158,841.47  | 活期   | 超募资金专户          |
| 合计             |                        |                      | 693,465,329.66 | 113,658,983.66 | /    |                 |

注 1：截止日募集资金专户余额 113,658,983.66 元与募集资金余额 434,658,983.66 元差异 321,000,000.00 元，为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款 201,000,000.00 元、证券公司保本型理财产品 120,000,000.00 元。

注 2：鉴于存放在“补充营运资金”专户江苏张家港农村商业银行股份有限公司的募集资金已按规定用途使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。截至 2024 年 4 月 10 日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。

### （二）募集资金先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。该授权自公司第二届董事会第八次会议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事均对该议案发表了同意意见。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。该授权自公司第二届董事会第十五次会议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事均对该议案发表了同意意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

| 签约方 | 产品名称 | 收益类型 | 投资日期 | 投资金额 | 投资期限<br>(天) | 截止日金额 |
|-----|------|------|------|------|-------------|-------|
|-----|------|------|------|------|-------------|-------|

| 签约方                    | 产品名称                                                | 收益类型      | 投资日期       | 投资金额           | 投资期限(天) | 截止日金额          |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------|----------------|
| 宁波银行股份有限公司张家港支行        | 单位结构性存款 7202403975                                  | 保本浮动收益型   | 2024-10-14 | 40,000,000.00  | 88      | 40,000,000.00  |
| 中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 381 期 K 款   | 保本浮动收益型   | 2024-9-23  | 14,000,000.00  | 268     | 140,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司张家港分行      | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号: 32298620020241125001) | 保本浮动收益型   | 2024-11-25 | 21,000,000.00  | 90      | 21,000,000.00  |
| 华泰证券股份有限公司             | 华泰证券股份有限公司聚益第 24577 号(中证 1000)收益凭证                  | 本金保障型收益凭证 | 2024-6-14  | 70,000,000.00  | 270     | 70,000,000.00  |
| 中信建投证券股份有限公司           | 中信建投收益凭证“看涨宝”550 期                                  | 本金保障浮动收益型 | 2024-12-3  | 50,000,000.00  | 350     | 50,000,000.00  |
| 合 计                    |                                                     |           |            | 321,000,000.00 |         | 321,000,000.00 |

注：公司在 2024 年度任何时点的现金管理合计金额均未超过董事会审议通过的现金管理限额。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币 4,000 万元的超募资金永久补充流动资金，该事项已经于 2024 年 5 月 8 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。截至 2024 年末，公司已使用超募资金永久补充流动资金人民币 4,000 万元。

#### (六) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

### （八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行普通股取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股A股，回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币57.66元/股（含），回购股份总金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年12月31日，公司尚未开展回购。

### （九）变更募投项目的资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。。

### （十）募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## 九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

### （一）控股股东、实际控制人的持股情况

公司的控股股东和实际控制人为丁国华先生。截至2024年末，丁国华先生直接持有公司15.20%股份，同时丁国华作为港晨芯的执行事务合伙人，通过港晨芯间接控制公司6.17%的表决权，根据2019年2月签署的《一致行动协议》，罗寅、港鹰实业、陈锴系丁国华的一致行动人，罗寅直接持有公司12.82%的股份，港鹰实业直接持有公司7.58%的股份，陈锴直接持有公司5.43%的股份。因此截至2024年末，丁国华先生直接和间接控制公司合计47.20%的表决权。

截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份不存在增减变动、质押、冻结及其他减持的情形。

## （二）董事、监事和高级管理人员的直接持股情况

截至2024年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员直接持有公司的股份情况如下：

| 序号 | 姓名  | 直接持股（万股）   | 职务或关系  |
|----|-----|------------|--------|
| 1  | 丁国华 | 1,119.8042 | 董事长    |
| 2  | 罗寅  | 944.5671   | 董事、总经理 |
| 3  | 陈锴  | 400.3350   | 董事     |
| 合计 |     | 2,464.7063 | -      |

截至2024年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有的公司股份不存在质押、冻结及其他减持的情形。

## 十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本跟踪报告出具日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



牟晶



吕瑜刚

